



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 54

(51) Int Cl.:
B23K 26/00 (2006.01) **B23K 26/06** (2006.01)
B23K 26/073 (2006.01) **B23K 26/36** (2006.01)
C03B 33/09 (2006.01) **C03B 33/10** (2006.01)
H01L 21/78 (2006.01) **H01L 31/18** (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
20.11.2013 Patentblatt 2013/47

(43) Veröffentlichungstag:
16.10.2013 Patentblatt 2013/42

(21) Anmeldenummer: **13162777.0**

(22) Anmeldetag: **08.04.2013**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

- **Ullmann, Ronny**
07751 Rothenstein (DE)
- **Heinig, Karsten**
07548 Gera (DE)
- **Matthies, Christian**
07774 Camburg (DE)
- **Weißer, Jürgen**
07743 Jena (DE)

(30) Priorität: **12.04.2012 DE 102012103176**

(71) Anmelder: **JENOPTIK Automatisierungstechnik GmbH**
07745 Jena (DE)

(74) Vertreter: **Schaller, Renate et al**
Patentanwälte Oehmke & Kollegen
Neugasse 13
07743 Jena (DE)

(72) Erfinder:
• **Nawrodt, Sebastian**
07629 Hermsdorf (DE)

(54) **Vorrichtung und Verfahren zum Einbringen von Trennrissen in ein Substrat unter Verwendung einer eine veränderbare Blendenöffnung aufweisenden Blende**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Einbringen von Trennrissen (7) in ein Substrat (2) unter Einwirkung eines Laserstrahls (31) mit einem elliptischen Strahlquerschnitt, mit einer Strahlflecklänge in einer Bewegungsrichtung entlang eines in das Substrat (2) einzubringenden Trennrisses (7). Sie sind besonders geeignet, wenn die Trennrisse (7) innerhalb der Substratoberfläche anfangen oder enden. Durch eine geeignete Blende (42) wird eine Strahleinwirkung auf das Substrat (2) vor dem Rissanfang und hinter dem Rissende vermieden.

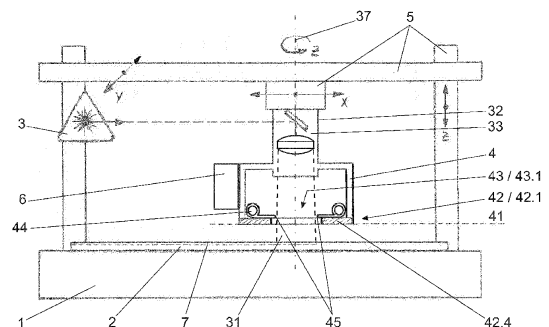


Fig. 1